

DISEÑO DE “SYSTEM IN PACKAGE”s DE ALTA FIABILIDAD PARA APLICACIONES DE ESPACIO

Desde el Instituto de Microelectrónica de Sevilla (CSIC, Universidad de Sevilla) estamos buscando un investigador para un contrato temporal a cargo de Proyecto USECHIP, Cátedra en Microelectrónica de la Universidad de Sevilla (referencia TSI-069100-2023-0001).

Entre los requisitos se encuentran:

- Titulación oficial requerida (u homologada) en Ingeniería, Física o disciplinas similares.
- Conocimientos y/o experiencia relativos al diseño de circuitos analógicos, en sentido amplio. En particular, idealmente, de circuitos integrados analógicos en tecnologías CMO.
- Inglés: competencia profesional (equivalente B2/C1) demostrable
- Autonomía y capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo.
- Se valorará experiencia laboral previa.

Tareas a realizar:

- Análisis de substratos: HTCC, LTCC, ORGANIC, etc
- Integración en sustrato de dispositivos pasivos: resistencias, condensadores, inductores, filtros, antenas, ...
- Técnicas de interconexión: wire-bonding, Flip chip, bumping, copper pillars, etc
- RDL, TSV, Fan-in, fan-out wafer packaging, interposer types,...
- Encapsulado final: hermetismo, moldeado, etc

¿Qué ofrecemos?

Contrato de Técnico Titulado Superior con 18 meses de duración.

Salario 2.283,94 €/mes brutos (incluido prorrateo pagas extras).

La dedicación será de 37,5 horas semanales.

Puesto de trabajo en las instalaciones del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSECNM), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Sevilla, con estancias periódicas en Alter Technology TÜV Nord.

Los candidatos interesados deberán enviar su CV a dgarcia@imse-cnm.csic.es en espera de la apertura de la convocatoria que tendrá lugar en octubre.